

第 2 4 回
エレクトロニクス実装学会春季講演大会
プログラム

会期 平成 22 年 3 月 10 日（水）～12 日（金）

会場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス

特別講演

期日 平成22年3月10日(水) 午後3時15分から5時15分

会場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 第講義室

講演

- ◆「実装技術とフレキシブル有機エレクトロニクス」
染谷 隆夫 (そめや たかお) 先生 / 東京大学
- ◆「超高周波・超低電力アナログ・RF LSI 技術」
—ミリ波・医療・環境などの新分野開拓に向けて—
松澤 昭 (まつざわ あきら) 先生 / 東京工業大学

依頼講演

3月10日(水)

- 10A-01 「プリント配線板における環境調和型技術の動向」
八甫谷 明彦 氏 (株式会社東芝)
- 10B-01 「LSI搭載ギガビット帯高速シリアルインターフェイスに関する技術動向」
多胡 州星 氏 (NECエレクトロニクス株式会社)

3月11日(木)

- 11A-01 「部品内蔵技術の国内及び国際標準化活動」
柴田 明一 氏 (社団法人日本電子回路工業会)
- 11A-02 「Cuコア部品内蔵配線板」
宮崎 政志 氏 (太陽誘電株式会社)
- 11A-03 「微細接続ファンアウトLSI内蔵パッケージの開発」
村井 秀哉 氏 (日本電気株式会社)
- 11A-04 「部品内蔵基板技術の新たな動きと狙うべき方向」
本多 進 氏 (NPO サーキットネットワーク)
- 11B-01 「1GHz超の放射エミッション規制」
宮崎 千春 氏 (三菱電機株式会社)
- 11B-08 「PI (Power Integrity) の歴史と今後の展開」
大塚 寛治 先生 (明星大学)
- 11C-08 「車載エレクトロニクス実装の現状と展望」
三宅 敏広 氏 (株式会社デンソー)

3月12日(金)

- 12A-05 「SiC素子に要求される実装技術」
山口 浩 氏 (独立行政法人産業技術総合研究所)
- 12A-08 「電気自動車技術の現状と将来」
田中 謙司 先生 (東京大学)
- 12B-09 「ウェアブルシステムによる人間状態計測技術」
才脇 直樹 先生 (奈良女子大学)
- 12C-01 「低消費電力光インターコネクト」
平 洋一 氏 (日本アイ・ビー・エム株式会社)
- 12C-12 「システムの性能向上に向けたSiP実装技術の課題について」
今村 和之 氏 (富士通マイクロエレクトロニクス株式会社)

第24回エレクトロニクス実装学会春季講演大会 プログラム

[illegible]

第 24 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会プログラム

会期：平成 22 年 3 月 10 日(水)～12 日(金) 会場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス

講演セッション 第 1 日目 (3 月 10 日)

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】
9:45	「材料技術」 座長：上田 充(東京工業大学) 10A-01 依頼講演 プリント配線板における環境調和型技術の動向 ○八甫谷明彦 ^{1,2} 、青木正光 ³ 、高橋昭雄 ² (株式会社 東芝 ¹ 、横浜国立大学 ² 、日本電子回路工業会 ³)	9:45	「高速伝送実装」 座長：荒井正史(日本 AMD) 10B-01 依頼講演 LSI 搭載ギガビット帯高速シリアルインターフェイスに関する技術動向 ○多胡州星 (NEC エレクトロニクス)	9:45	「信頼性解析技術」 座長：津久井 勤 (リサーチラボ・ツクイ) 10C-01 亜鉛ウィスカの発生及びそのメカニズム ○阿龍 恒 ¹ 、金 樺鉄 ² 、菅沼克昭 ² (大阪大学大学院 ¹ 、大阪大学産業科学研究所 ²)
				10:00	10C-02 めっき銅薄膜配線マイグレーション耐性の微細組織依存性 ○斎藤直樹、村田直一、玉川欣治、鈴木 研、三浦英生 (東北大学大学院)
10:15	10A-02 ガラスエポキシ樹脂上を用いた高密度シード層めっきの形成 ○金森元気 ¹ 、田中慎也 ¹ 、渡辺充広 ² 、本間英夫 ^{1,2} (関東学院大学 ¹ 、(株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	10:15	10B-02 セラミック PGA パッケージとソケットによる Gbps 級信号伝送 ○山岸圭太郎 ¹ 、石橋拓真 ² 、亀谷聡一郎 ¹ 、小林 剛 ¹ 、大橋英征 ¹ 、斉藤成一 ¹ (三菱電機株式会社 ¹ 、三菱電機エンジニアリング株式会社 ²)	10:15	10C-03 エリアアレイバンプ実装チップの局所変形に及ぼすアンダーフィル材質の影響 ○中平航太、岸 宏樹、鈴木 研、三浦英生 (東北大学大学院)
10:30	10A-03 印刷金属パターンの合金化技術の開発 ○吉田 学、末森浩司、植村 聖、星野 聡、高田徳幸、小笹健仁、鎌田俊英 (産業技術総合研究所)	10:30	10B-03 超高速伝送向け基板材料の検討について ○須和田 誠 (富士通アドバンストテクノロジー株式会社)	10:30	10C-04 AES によるステンレス鋼自然酸化皮膜と溶融純 Sn の反応解析 ○瀬下洋平 ¹ 、荻谷義治 ² 、木村 隆 ³ (芝浦工業大学大学院 ¹ 、芝浦工業大学 ² 、物質・材料研究機構 ³)
10:45		10:45		10:45	
11:00	「材料技術」 座長：飯田隆久(住友ベークライト) 10A-04 Study on Benzoxazine Resin Modified with Epoxy Resin ○賀川美香 ^{1,2} 、高橋昭雄 ¹ 、大山俊幸 ¹ (横浜国立大学 ¹ 、財団法人神奈川科学技術アカデミー ²)	11:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：和田光司(電気通信大学) 10B-04 アンダーフィル材料がミリ波 MMIC に及ぼす影響の検討 ○清水隆志 ¹ 、中野 洋 ^{2,3} 、須賀良介 ³ 、古神義則 ¹ 、平地康剛 ^{2,3} (宇都宮大学 ¹ 、株式会社アムシス ² 、東京工業大学 ³)	11:00	「検査技術」 座長：山崎 浩(日置電機) 10C-05 静電容量型微細プリント配線検査システムに関する研究 ○野口祐智、斎藤之男、角田興俊 (東京電機大学)
11:15	10A-05 β-ケトカルボン酸銀塩インクの分解過程および配線特性に関する研究 ○桑名貴弘 ¹ 、畑村真理子 ² 、和久田大介 ¹ 、菅沼克昭 ² (大阪大学大学院 ¹ 、大阪大学産業科学研究所 ²)	11:15	10B-05 シールド付き平衡ケーブルのノイズ耐性評価法における一検討 ○鈴木雄将、米田 諭、大橋英征、斉藤成一、岡 尚人、小林 剛 (三菱電機株式会社)	11:15	10C-06 プリント配線板クーポンを用いた各種電気的特性評価法 ○水科秀樹、廣川正孝、上谷 純、芳賀 知 (沖プリンテッドサーキット株式会社)
11:30	10A-06 狭ピッチ対応先置きアンダーフィル剤の開発 ○野村和宏 ¹ 、水野巧也 ¹ 、磯部友基 ¹ 、小倉信雄 ² (ナガセケムテックス株式会社 ¹ 、長瀬産業株式会社 ²)	11:30	10B-06 平衡度不整合理論に基づく多チャンネル差動伝送線路のコモンモード放射予測 ○松嶋 徹 ¹ 、渡辺哲史 ² 、豊田啓孝 ³ 、古賀隆治 ³ 、和田修己 ¹ (京都大学 ¹ 、岡山県工業技術センター ² 、岡山大学 ³)	11:30	10C-07 IC 内組込型インターコネクトオープン検出回路 ○橋爪正樹 ¹ 、内倉健一 ¹ 、小野安季良 ² 、四柳浩之 ¹ 、高木正夫 ² (徳島大学大学院 ¹ 、香川高等専門学校 ²)
11:45	10A-07 高速硬化銀ペースト ○小清水和敏 ¹ 、小野明伸 ¹ 、今井隆之 ¹ 、太田茂男 ² 、田中信也 ² (株式会社フジクラ ¹ 、互応化学工業株式会社 ²)	11:45	10B-07 40 GHz 信号伝送における差動ペア内スキューの影響 ○野崎孝英、中西秀行、田中顕裕 (アイカ工業株式会社)	11:45	10C-08 2次元画像検出器を用いた3角測量方式微小ボール高さ検出法の研究 ○原 靖彦 ¹ 、河田成広 ² 、白井健二 ¹ 、小林義和 ¹ 、足立秀之 ³ 、滝沢義信 ³ 、菅野純一 ³ (日本大学工学部 ¹ 、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 ² 、ヴィスコ・テクノロジー株式会社 ³)
12:00	休憩	12:00	10B-08 FPC における回路設計が伝送特性に与える影響 ○笹岡典史 (ニッポン高度紙工業株式会社)	12:00	休憩
		12:15	10B-09 DCAM『START』による解析モデルの最適化 ○斎藤和之 (株式会社ファースト)		
		12:30	休憩		

第1日目【3月10日】

ポスターセッション

場所：D会場

座長：牧野俊彦（リコー）

- 10:00 **10DP-01** ネガ型反応現象画像形成法によるアダマンタン骨格含有ポリカーボネートへの微細パターン形成
○安田宗平¹，高橋昭雄¹，大山俊幸¹，山尾 忍²（横浜国立大学大学院¹，出光興産株式会社²）
- 10:05 **10DP-02** ダイヤモンド型構造物質による Sn 同素変態の促進効果
○高橋和也¹，関 景樹²，平野悠太²，荻谷義治¹（芝浦工業大学¹，芝浦工業大学大学院²）
- 10:10 **10DP-03** 印刷・射出技術を用いた導電性接着剤の配線形状制御
○和久田大介¹，加賀美宗子²，菅沼克昭²（大阪大学大学院¹，大阪大学産業科学研究所²）
- 10:15 **10DP-04** ジビニルベンゼン含有オレフィン系マクロモノマーの架橋体を用いた絶縁材料
○佐々木絵梨，荒井 亨（電気化学工業株式会社中央研究所）
- 10:20 **10DP-05** エンベッデッドキャパシタによる同時スイッチングノイズ低減効果の検討
○金子 聡，須藤俊夫（芝浦工業大学）
- 10:25 **10DP-06** SPICE モデルを用いた PI/EMI の実測と解析の相関
○東 賢一郎，須藤俊夫（芝浦工業大学）
- 10:30 **10DP-07** 核融合実験施設における高周波電磁界測定と電磁干渉評価
○陳 紹郎，王 建青（名古屋工業大学大学院）
- 10:35 **10DP-08** FPGA の同時スイッチングノイズの実測と解析の一致性
○高橋 遥¹，須藤俊夫¹，太田邦夫²，松毛和久²（芝浦工業大学¹，株式会社東芝²）
- 10:40 **10DP-09** EBG 構造の阻止帯域広帯域化に関する一考察
○野瀬正秀，須藤俊夫（芝浦工業大学）
- 10:45 **10DP-10** 高速コンパレータを用いた回路における電磁的感受性の特性評価
○谷口知弘，王 建青（名古屋工業大学）
- 10:50 **10DP-11** オンチップキャパシタによる電源電流変動の低減度評価
○星野幸三¹，里見竜輝¹，須藤俊夫¹，岡野宏計²，石川美由紀²，柴山裕征²，山岸邦彦²，青柳洋史²，櫛部秀文²（芝浦工業大学¹，東芝セミコンダクター社²）
- 10:55 休憩
- 座長：寺崎 健（日立製作所）
- 11:00 **10DP-12** 微小導電性接着継手の低サイクル疲労寿命におよぼす温度および保持時間の影響
○古澤弘充¹，井口恵太郎²，神田喜彦²，荻谷義治¹（芝浦工業大学¹，芝浦工業大学大学院²）
- 11:05 **10DP-13** 微小体積における Sn 基合金の力学特性
○小田切 啓¹，神田喜彦¹，荻谷義治²（芝浦工業大学大学院¹，芝浦工業大学²）
- 11:10 **10DP-14** CSP 実装部の機械的せん断疲労寿命におよぼす負荷波形の影響
○藤澤仁之¹，神田喜彦²，荻谷義治¹，大田広徳³，菊池俊一⁴，山部英喜⁵，中村一彦⁶（芝浦工業大学¹，芝浦工業大学大学院²，日本電気株式会社³，富士通アドバンステクノロジー株式会社⁴，株式会社日本スベリア社⁵，HDP User Group International Inc.⁶）
- 11:15 **10DP-15** Sn-Ag-Cu 微小はんだの疲労延性指数および係数の温度・周波数依存性
○大戸悠司¹，岡崎和也²，神田喜彦¹，荻谷義治²（芝浦工業大学大学院¹，芝浦工業大学²）
- 11:20 **10DP-16** 低 Ag 系鉛フリーはんだ合金の力学特性
○居初隼人¹，座間邦宏¹，荻谷義治²，渡邊裕彦³，日高 昇³，浅井竜彦³（芝浦工業大学大学院¹，芝浦工業大学²，富士電機ホールディングス(株)生産技術研究センター³）
- 11:25 **10DP-17** 超微小 SnAgCu はんだ接合部の疲労破壊機構
○田代直樹¹，佐藤加奈²，浅利翔太¹，荻谷義治¹（芝浦工業大学¹，芝浦工業大学大学院²）
- 11:30 **10DP-18** 薄型ベアチップ実装構造における曲げ環境下の応力解析
手島由博¹，○大田直樹²，荻谷義治¹，池内達也²（芝浦工業大学¹，大日本印刷株式会社²）
- 11:35 **10DP-19** フラックス残渣によるアンダーフィル封止信頼性に及ぼす影響
○渡辺 潤^{1,2}，宮崎 誠¹，初澤健次¹，荘司郁夫³（長野沖電気株式会社¹，沖プリンテッドサーキット株式会社²，群馬大学大学院³）
- 11:40 **10DP-20** パッシベーション窒化膜のメタライゼーションの基礎的検討
○梅本博史¹，配島雄樹²，橋本 晃¹，小岩一郎¹（関東学院大学¹，関東学院大学工学総合研究所²）
- 11:45 **10DP-21** 化学増幅型レジストへのめっきの適用の基礎的検討
○柳沢拓未¹，配島雄樹²，高梨 博¹，加藤義之³，伊東克浩³，小岩一郎^{1,2}（関東学院大学¹，関東学院大学大学院²，協和発酵ケミカル株式会社³）

ものづくりセッション

場所：D会場

座長：本多 進（NPO サーキットネットワーク）

- 13:00 **10D-01** 低熱膨張率・高耐熱性ハロゲンフリー基材 MCL-E-700G
○小竹智彦¹，高根沢 伸¹，村井 曜¹，土川信次¹，宮武正人¹，竹越正明¹，入野哲朗²（日立化成工業株式会社筑波総合研究所¹，日立化成工業株式会社電子材料事業部配線板材料部門²）
- 13:20 **10D-02** アルカリ現像型新規シリコン系光導波路の作製
○石川佳寛，岩島智幸，末吉 孝，斎藤誠一（株式会社 ADEKA）
- 13:40 **10D-03** シリカハイブリッドを用いた多層基板用層間絶縁材料の開発
○田崎崇司，濱澤晃久，合田秀樹（荒川化学株式会社）

第1日目【3月10日】

【表彰式】

2009年秋季講演大会の講演大会優秀賞および研究奨励賞の表彰

時間：14:45～15:10

場所：交流棟 大講義室

〈注〉ポスターアワードの表彰式は第3日目（3月12日）13:00～13:30

【特別講演】

日時：15:15～17:15

場所：交流棟 大講義室

座長：須藤俊夫（芝浦工業大学）

◆東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授 染谷 隆夫
「実装技術とフレキシブル有機エレクトロニクス」

◆東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 教授 松澤 昭
「超高周波・超低電力アナログ・RF LSI 技術」
—ミリ波・医療・環境などの新分野開拓に向けて—

【交流会】

日時：17:30～19:00

場所：交流棟 2階ラウンジ

講演セッション 第2日目（3月11日）(1/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
9:45	「部品内蔵基板技術」 座長：小岩一郎(関東学院大学) 11A-01 依頼講演 部品内蔵技術の国内及び国際標準化活動 ○柴田明一（(社)日本電子機械工業会）	9:45	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：高橋文博(拓殖大学) 11B-01 依頼講演 1 GHz 超の放射エミッション規制 ○宮崎千春（三菱電機株式会社）		
				10:00	「材料技術」 座長：高橋昭雄(横浜国立大学) 11C-01 メソゲンを含有するエポキシ樹脂コンポジットシートの開発 ○西山智雄，高橋裕之，片木秀行，原 直樹，竹澤由高（日立化成工業(株)）
10:15	11A-02 依頼講演 Cu コア部品内蔵配線板 ○宮崎政志，井田一昭，宮崎正和，猿渡達郎，横田英樹，小林浩之，濱田芳樹，杉山裕一（太陽誘電株式会社）	10:15	11B-02 高速信号の動作モードによるEMI 評価 ○金子俊之(株式会社トッパンNECサーキットソリューションズ)	10:15	11C-02 FC-BGA 基板における低反り対応低熱膨張基材の検討 ○中村吉宏 ^{1,2} ，池葉香澄 ¹ ，竹越正明 ¹ ，土川信次 ¹ ，尾崎純一 ² （日立化成工業株式会社 ¹ ，群馬大学大学院 ² ）
		10:30	11B-03 MUSIC 法を用いた近傍電磁波源推定に関する基礎的検討とEMC 測定への応用 ○福田明生，越地耕二(東京理科大学大学院)	10:30	11C-03 低熱膨張性半脂環式ポリイミドの感光性化 ○小倉知士，東原知哉，上田 充（東京工業大学大学院）
10:45	休憩	10:45	休憩	10:45	休憩
11:00	「部品内蔵基板技術」 座長：猪川幸司(日本CMK) 11A-03 依頼講演 微細接続ファンアウトLSI内蔵パッケージの開発 ○村井秀哉 ¹ ，森 健太郎 ¹ ，川野連也 ² ，山道新太郎 ¹ （NEC デバイスプラットフォーム研究所 ¹ ，NEC エレクトロニクス ² ）	11:00	「回路・実装設計技術」 座長：高橋邦明(エスベック) 11B-04 モバイル電子機器用ワイヤレス電力・情報伝送システムに関する検討 ○八木 慧，越地耕二（東京理科大学大学院）	11:00	「材料技術」 座長：田畑晴夫(大阪大学) 11C-04 有機繊維を用いた極薄低熱膨張繊維物の開発 ○上杉健太郎，吉川真士，権藤義宣，木村康之（旭化成イーマテリアルズ株式会社）
		11:15	11B-05 アンテナループ間の効率的な空間電力伝送の解析 ○菊地秀雄(株式会社トッパンNECサーキットソリューションズ)	11:15	11C-05 熱可塑性ポリイミド放熱材の開発 ○飯田健二，三宮 啓，朝比奈浩太郎（三井化学株式会社）
11:30	11A-04 依頼講演 部品内蔵基板技術の新たな動きと狙うべき方向 ○本多 進（NPO 法人サーキットネットワーク）	11:30	11B-06 熱流体シミュレーションによる多連実装を想定した光トランシーバの放熱検討 ○河村裕史，沖 和重，倉島宏実（住友電気工業株式会社 伝送デバイス研究所）	11:30	11C-06 液晶構造の制御によるエポキシ/BN 充填系の高熱伝導化 ○原田美由紀，濱浦奈々，越智光一（関西大学）
		11:45	11B-07 シミュレーションによるはんだ接合後の変形推定 ○山田 靖 ¹ ，近藤継男 ¹ ，菊池俊彦 ² ，星名博文 ² ，日出勝利 ² （豊田中研 ¹ ，テラバイト ² ）	11:45	11C-07 低誘電正接・低CTEビルドアップ絶縁材料 ○小林剛之，田中俊章，鈴木 勲（積水化学工業株式会社 R&D センター）
12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	休憩
13:00	「部品内蔵基板技術」 座長：福岡義孝(ウェイスティー) 11A-05 ペアチップ内蔵基板におけるAu スタッドバンプ接合部の解析 ○見山克己 ¹ ，田中大之 ² ，片山直樹 ² （クローバー電子工業株式会社 ¹ ，北海道立工業試験場 ² ）	13:00	「回路・実装設計技術」 座長：谷 貞宏(シャープ) 11B-08 依頼講演 PI (Power Integrity) の歴史と今後の展開 ○大塚寛治，秋山 豊，橋本 薫，藤井文明，河野一雄（明星大学）	13:00	「電子部品・実装技術」 座長：関 善仁(シャープ) 11C-08 依頼講演 車載エレクトロニクス実装の現状と展望 ○三宅敏広（株式会社デンソー）

講演セッション 第2日目(3月11日)(2/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
13:15	11A-06 超低インピーダンスアナライザを用いたキャパシタ内蔵インターポータの電源プレーン評価 ○菊地克弥 ¹ , 竹村浩一 ² , 上田千寿 ³ , 島田 修 ² , 五明利雄 ² , 竹内之治 ² , 大久保利一 ² , 馬場和宏 ² , 青柳昌宏 ¹ , 須藤俊夫 ⁴ , 大塚寛治 ³ (産業技術総合研究所 ¹ , 超先端電子技術開発機構 ² , 明星大学 ³ , 芝浦工業大学 ⁴)		11B-08 つづき		11C-08 つづき
13:30	11A-07 三次元集積化へ向けたSrTiO ₃ 薄膜キャパシタのインピーダンス特性 ○竹村浩一 ¹ , 菊地克弥 ² , 上田千寿 ³ , 馬場和宏 ¹ , 青柳昌宏 ² , 大塚寛治 ³ (超先端電子技術開発機構 ¹ , 産業技術総合研究所 ² , 明星大学 ³)	13:30	11B-09 電源インピーダンスへのチップ等価回路の影響 ○富島敦史 ¹ , 岡野資睦 ² , 金子俊之 ³ (株式会社東芝セミコンダクター社 ¹ , 株式会社東芝PC&ネットワーク社 ² , 株式会社トッパンNECサーキットソリューションズ ³)	13:30	11C-09 Sn-Ag-Cu系鉛フリーはんだの初晶Ag ₃ Sn晶出後の凝固過程 ○鷹松喜子, 江阪久雄, 篠塚 計 (防衛大学校)
13:45	11A-08 薄膜キャパシタの高容量化とインターポータ形成技術 ○棚瀬智和 ¹ , 中野 広 ¹ , 天羽 悟 ¹ , 赤星晴夫 ² , 平田善毅 ³ (日立製作所・材料 ¹ , 日立製作所・日立研究所 ² , 日立化成工業(株) ³)	13:45	11B-10 コンデンサ内蔵インターポータによるノイズ耐性の向上 ○佐々木智江 ¹ , 齊藤義行 ¹ , 高橋英治 ¹ , 菅谷康博 ² , 小林秀樹 ² (パナソニック(株) ¹ , パナソニックエレクトロニクスデバイス(株) ²)	13:45	11C-10 Sn-Ag-Cu-Niはんだボール接合部の熱疲労特性に関する研究 ○川城史義 ¹ , 吉川雅章 ¹ , 高橋 聡 ¹ , 鶴田久幸 ¹ , 衛藤敬基 ¹ , 岡田弘史 ² (NECエレクトロニクス株式会社 ¹ , 千住金属工業株式会社 ²)
14:00		14:00	11B-11 PCB電源プレーン構造によるEMI放射特性の検討 ○上田千寿 ¹ , 大塚寛治 ² (エーイーティ- ¹ , 明星大学 ²)	14:00	11C-11 はんだペーストぬれ広がり試験におよぼす印刷形状の影響 ○山本健一 (株式会社ルネサステクノロジ)
14:15	「配線板製造技術」 座長: 宮崎 純 (旭化成イーマテリアルズ) 11A-09 SAP(セミアディティブ)におけるトップ形状平坦化となる硫酸銅めっき浴について ○大野晃宜 ¹ , 江田哲朗 ² (荏原ユーザイト株式会社海外事業部 ¹ , 総合研究所 ²)	14:15	休憩	14:15	休憩
14:30	11A-10 低粗度セミアディティブ基板への高密着無電解銅めっきの検討 ○清水 悟, 安田弘樹, 岩切 彩, 佐藤麻里 (荏原ユーザイト株式会社)	14:30	「高速高周波・電磁特性技術」 座長: 井関裕二(東芝) 11B-12 マイクロストリップ線路の伝搬定数の計算および実験 ○吉富了平, 小林禧夫, 馬 哲旺 (埼玉大学)	14:30	「電子部品・実装技術」 座長: 桜井 博(ヤマハ) 11C-12 レーザ加工を適用した半導体パッケージング技術 ○能木孝男 ¹ , 高木 始 ¹ , 木谷智之 ² , 菅 謙太郎 ² , 東條 啓 ² , 樋口和人 ² , 大谷和巳 ¹ , 大谷忠夫 ¹ ((株)東芝セミコンダクター社 ¹ , (株)東芝生産技術センター ²)
14:45	11A-11 フィールドピア銅めっきにおけるジアル系アミン添加剤の効果 ○久利英之 ¹ , 岡本尚樹 ¹ , 齊藤丈靖 ¹ , 近藤和夫 ¹ , 文屋 勝 ² , 竹内 実 ² (大阪府立大学大学院 ¹ , 日東紡績株式会社 ²)	14:45	11B-13 右手・左手系複合線路を用いた線路間の結合特性の検討 ○勝又雅基, 越地耕二 (東京理科大学大学院)	14:45	11C-13 エキシマレーザーによるピアホール形成と電気銅めっきによる充填を行なったW-CSPによるマルチチップモジュールの作製 ○小岩一郎 ¹ , 鈴木 隆 ² , 田村俊夫 ² , 小岩賢太郎 ² , 和久田陽平 ² , 山田忠昭 ² , 安藤 聡 ³ , 松野 明 ³ (関東学院大学 ¹ , (株)野毛電気工業 ² , フェトン株式会社 ³)
15:00	11A-12 ピアフィリングのめっき成長メカニズム ○和久田陽平 ¹ , 杉本将治 ² , 渡辺充広 ² , 本間英夫 ^{1,2} (関東学院大学 ¹ , (株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	15:00	11B-14 マルチモードTM _{0m0} 空洞共振器を用いた高損失誘電体丸棒の複素誘電率のマイクロ波測定 ○金子彰吾 ¹ , 小林禧夫 ² , 馬 哲旺 ¹ (埼玉大学 ¹ , サムテック(有) ²)	15:00	11C-14 貼り合わせ工法を用いた新規ウェハレベルパッケージング技術における接合構造の検討 ○柳瀬康行, 中里真弓, 齋藤浩一, 小林 初, 鈴木敦順, 藤井隆弘, 岡山芳央, 臼井良輔 (三洋電機株式会社アドバンスデバイス研究所)

講演セッション 第2日目 (3月11日) (3/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
15:15	座長：和嶋元世(荏原ユーザライト) 11A-13 硫酸銅めっき浴を用いたスルーホールフィリング ○小林正樹 ¹ , 丸山貴昭 ¹ , 杉本将治 ² , 香西博明 ¹ , 本間英夫 ^{1,2} (関東学院大学 ¹ , (株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	15:15	11B-15 マルチモード TE _{0m1} 空洞共振器を用いた誘電体基板の平面方向の複素誘電率測定に関する測定精度の検討 ○小林禰夫 ¹ , ホサイン S. M., ナザラット ² , 馬 哲旺 ² (サムテック(有) ¹ , 埼玉大学 ²)	15:15	11C-15 X線FPD用CdTe-ASICハイブリッドモジュールの開発 ○三戸美生, 小泉達洋, 喜名 徹 (株式会社アクロラド)
15:30	11A-14 無電解めっきにおけるCuを用いた触媒法の検討 ○加藤友人 ¹ , 馬場邦人 ^{1,2} , 渡辺充広 ² , 本間英夫 ^{1,2} (関東学院大学 ¹ , (株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	15:30	11B-16 シクロオレフィンポリマー基板のマイクロ波・ミリ波特性測定 ○和田山修平 ¹ , 小林禰夫 ² , 馬 哲旺 ¹ (埼玉大学 ¹ , サムテック(有) ²)	15:30	11C-16 高熱伝導ダイボンディング材を用いた高放熱パッケージの放熱特性 ○米田奈柄 ¹ , 河野賢哉 ¹ , 山田和彦 ² , 林 宏樹 ² (日立製作所 ¹ , 日立化成工業 ²)
15:45		15:45		15:45	休憩
16:00	「配線板製造技術」 座長：和嶋元世(荏原ユーザライト) 11A-15 電気銅めっき配線材料の高強度化の検討 ○松田光由 ^{1,2} , 高橋拓也 ¹ , 吉原佐知雄 ¹ , 土橋 誠 ³ (宇都宮大学大学院 ¹ , 三井金属鉱業(株)総合研究所 ² , 三井金属鉱業(株) ³)	16:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：和田修己(京都大学) 11B-17 シミュレーションによるサイドチャネル解析に向けた標準ボードの予備測定 ○片下敏宏, 佐藤 証, 菊地克弥, 仲川 博, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所)	16:00	「電子部品・実装技術」 座長：高見和憲(村田製作所) 11C-17 表面活性化接合における不均一性の改善に関する研究 ○平 将人, 須賀唯知, 王 英輝, 魯 健 (東京大学)
16:15	11A-16 PRパルス電解硫酸銅めっき用添加剤の効果 ○岩本由香, 西城信吾, 松浪卓史 (奥野製薬工業株式会社)	16:15	11B-18 不完全グランド面上の帰路電流経路シミュレーション ○酒井辰也 ¹ , 作左部剛視 ² , 高橋丈博 ² , 澁谷 昇 ² (拓殖大学大学院 ¹ , 拓殖大学 ²)	16:15	11C-18 金薄膜と垂直配向多層カーボンナノチューブの表面活性化接合 ○藤野真久 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 曾我育夫 ² , 近藤大雄 ² , 石月義克 ² , 水越正孝 ² , 岩井大介 ² (東京大学 ¹ , 富士通研究所, 富士通 ²)
16:30	座長：雀部俊樹(メイコー) 11A-17 大気UV処理を用いた平滑なエポキシ樹脂へのめっき ○金田龍馬 ¹ , 杉本将治 ² , 田代雄彦 ² , 渡辺充広 ² , 本間英夫 ¹ (関東学院大学 ¹ , (株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	16:30	11B-19 多層プリント基板の電源・グランドプレーン低インピーダンス化に関する検討 ○二村和則, 八木貴弘, 芳賀 知 (沖プリンテッドサーキット株式会社)	16:30	11C-19 はんだ粒子含有ペーストを用いたFPC接続技術の開発 ○圓尾弘樹, 本村耕治, 永福秀喜, 境 忠彦 (パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社)
16:45	11A-18 UV改質処理を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライジング ○西村宜幸 ¹ , 新城沙耶加 ¹ , 馬場邦人 ^{1,2} , 渡辺充広 ² , 本間英夫 ^{1,2} (関東学院大学 ¹ , (株)関東学院大学表面工学研究所 ²)	16:45	11B-20 コモンモード電流分布に与えるデカップリング素子の影響 ○糸原和也 ¹ , 増田幸一郎 ² , 越地耕二 ¹ (東京理科大学大学院 ¹ , NECシステム実装研究所 ²)	16:45	11C-20 FCBGAのFCB工程に対する検討 ○天利 聡 ¹ , 大島政男 ¹ , 谷口文彦 ¹ , 庄野 健 ¹ , 鈴木貴志 ² (富士通マイクロエレクトロニクス(株) ¹ , 富士通研究所(株) ²)
17:00	11A-19 銅表面上分子界面(Molecular Interface)のエポキシ材ラミネート及びHAST試験後への影響 Kuhre Werner ¹ , Shi Steven ¹ , Rhodine Craig ¹ , 中村茂雄 ² , 〇久保田陽一 ¹ (ゼタコア Inc. ¹ , 味の素株式会社 ²)	17:00	11B-21 プリント基板における電源供給ラインの高周波ノイズ抑制手法 ○本木浩之, 中西秀行, 田中顕裕 (アイカ工業株式会社)	17:00	11C-21 次世代バンプレス接続に向けたケミカル・フリップチップボンディング-析出挙動とブリッジ接続実現の関 ○山地泰弘 ¹ , 横島時彦 ² , 井川 登 ¹ , 菊地克弥 ¹ , 仲川 博 ¹ , 青柳昌宏 ¹ ((独)産業技術総合研究所 ¹ , 早稲田大学 ²)
17:15	11A-20 ケミカルミリング用ドライフィルム ○国松真一, 小谷雄三, 五十嵐 勉, 扇谷 聡 (旭化成イーマテリアルズ株式会社)	17:15	11B-22 スイッチング電源基板のモデリングと評価 ○高橋成正 (日本アイ・ビー・エム株式会社)		
17:30	11A-21 グラフトポリマー誘電体基板を用いた60GHzストリップラインフィルタ ○城田健一 ¹ , ウー ホクホア ² , 西清次 ² (沖プリンテッドサーキット(株) ¹ , 沖電気工業(株) ²)	17:30	11B-23 アンテナ経由の機器内電磁干渉問題に対応した設計手法の検証 ○前川智哉, 岩城秀樹, 山田 徹, 小川晃一 (パナソニック株式会社)		

第2日目【3月11日】

ものづくりセッション

場所：D 会場

		座長：星 幸紀（大昌電子）
9:45	11D-01	次世代を目指す硫酸銅めっき技術 ○小合康裕，佐藤琢朗（荏原ユーザライト株式会社）
10:05	11D-02	無電解 Ni-P/Pd/Au めっきプロセス「トップ NPG プロセス」 ○津野勇輝（奥野製薬工業株式会社）
10:25	11D-03	水平めっき装置を使用した，ビアフィリング技術 ○藤原俊弥（アトテックジャパン株式会社）
10:45		休憩
		座長：中尾 知（フジクラ）
11:00	11D-04	プラズマ処理の効果とその応用 ○佐波正浩（荏原ユーザライト株式会社）
11:20	11D-05	次世代半導体実装基板用の微細銅配線の表面処理技術 ○井上文男，山下智章，有家茂晴（日立化成工業株式会社）
11:40	11D-06	ファインパターン回路形成用レジスト技術 ○豊田裕二，入澤宗利，梶谷邦人，金田安生，中川邦弘（三菱製紙株式会社）
12:00		休憩
		座長：和嶋元世（荏原ユーザライト）
13:00	11D-07	部品内蔵技術を用いた小型三次元モジュール ○島田 修，笹岡賢司，豊吉令欧，荒木 登，勝原康彦，本村知久（大日本印刷株式会社）
13:20	11D-08	多孔質層と銀ナノ粒子インクによる焼成不要な導電性パタン形成技術 ○志野成樹（三菱製紙株式会社 イメージング & ディベロップメントカンパニー京都 R&D センター）
13:40	11D-09	プリント配線板の最新技術動向 ○上原利久（（株）トッパン NEC サーキットソリューションズ）
14:00	11D-10	ベアチップ内蔵基板の実用化事例とその実装技術 ○見山克己（クローバー電子工業株式会社）
14:20		休憩
		座長：猪川幸司
14:30	11D-11	スーパージャフィット (SJ) 法による微小はんだバンプ形成 荘司孝志，○堺 丈和（昭和電工株式会社）
14:50	11D-12	「MEMS 組立」光 MEMS，化学センサ向け実装技術の提案 ○千野 満，伊澤早苗，真弓功人，島田照男（株式会社ミスズ工業）
15:10	11D-13	多層プリント配線板用材料「MEGTRON4」 ○今井雅夫，藤澤洋之，田宮裕記（パナソニック電工株式会社）
15:30	11D-14	LED 用高反射白色ソルダーレジスト ○青山良朋，依田愛子，西尾一則，関本晃男（太陽インキ製造株式会社）
15:50		休憩
		座長：中尾 知（フジクラ）
16:00	11D-15	微細貫通配線用超多穴加工ガラス基板 ○小用広隆，倉知淳史，小路谷将範，坂口浩一，常友啓司（日本板硝子株式会社）
16:20	11D-16	DOWA 高耐熱性銀ナノペースト ○長原愛子，遠藤圭一，久枝 穰，池田浩也，松坂裕治（DOWA エレクトロニクス株式会社）
16:40	11D-17	湿式無電解めっき可能なポリイミドフィルムの開発 ○濱澤晃久 ¹ ，合田秀樹 ¹ ，陳 宗儀 ² ，村上朋史 ³ （荒川化学工業株式会社 ¹ ，タイマイド ² ，奥野製薬工業株式会社 ³ ）
17:00	11D-18	車載用基板 ○齋藤紀之（日本シイエムケイ株式会社）

第2日目【3月11日】

—— 学生・初学者向けチュートリアルセッション ——
—— 実装技術を基礎から分かり易く説明する講義 ——

共催：YUVEC（YJC: よこはま高度実装コンソーシアム）

日時：3月11日(木) 10:00～15:10

場所：E会場

①10:00～10:30

電子機器における電子回路実装の重要性

羽深 等（横国大教授）

②10:30～11:10

電子部品の出来るまで（LSI, L, C, R, 他）
（10分間休憩）

本多 進（YJC）

③11:20～12:00

プリント配線板の出来るまで（材料, プロセス, 動向）
（昼食）

高木 清（YJC）

④13:00～13:40

パソコンの実装トレンド

井上博文（NEC）

⑤13:40～14:20

携帯電話の実装トレンド
（10分間休憩）

森島光紀（森島技術士事務所）

⑥14:30～15:10

自動車のエレクトロニクス化（EV, HCV, 他）

宮代文夫（YJC）

〈15:20 より高校生の希望者に芝浦工業大学キャンパスの案内を計画しております。（参加自由）〉

講演セッション 第3日目 (3月12日) (1/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
				9:30	「光回路実装技術」 座長：三上 修(東海大学) 12C-01 依頼講演 低消費電力光インターコネクト ○平 洋一 ¹ , 沼田英俊 ¹ , 徳成正雄 ¹ , Heroux Jean ¹ , 中川 茂 ¹ , Kash Jeffery ² , Taubenblatt Marc ² (日 本IBM 東京基礎研究所 ¹ , IBM ワ トソン研究所 ²)
9:45	「信頼性解析技術」 座長：寺崎 健(日立製作所) 12A-01 デジタル画像相関法によるリ フロー中の三次元熱変形評価 ○高梨泰幸, 池田健一, 金築俊介, 荒木俊二, 三宅修吾, 鈴木康平 (株)コベルコ科研)	9:45	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：小久保光典(東芝機械) 12B-01 異種材料に接合した半導体 レーザー素子の残留応力分布に関する 研究 ○佐藤丈史 ¹ , 日暮栄治 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 澤田廉士 ² (東京大学 ¹ , 九州大学 ²)		
10:00	12A-02 部分補強材による CSP (Chip Scale Package) の落下接続信頼性 の改善 ○本村耕治, 吉永誠一, 境 忠彦, 酒見省二 (パナソニックファクト リーソリューションズ株式会社)	10:00	12B-02 低温接合のための n-GaN の Cr/Au 室温オーミックコンタクト ○福永 徹 ¹ , 日暮栄治 ^{1,2} , 須賀唯知 ¹ (東京大学大学院 ¹ , 東京大学先端科 学技術研修センター ²)	10:00	12C-02 光プリント板へ直接搭載可能 な三次元集積小型光モジュールの検 討 ○杉本 宝, 前田勝美, 小野秀之, 栗林亮介, 橋本義仁, 柳町成行 (日 本電気株式会社ナノエレクトロニク ス研究所)
10:15	12A-03 はんだ接合の低温下における 高加速寿命試験 ○森田 将, 林 信幸, 中西 輝, 本吉勝貞, 米田泰博 (株式会社富士 通研究所)	10:15	12B-03 光熱励振マイクロカンチレ バーとレーザー干渉変位計を用いたマ イクロデバイス内部の圧力測定 ○山本真一 ¹ , 日暮栄治 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 澤田廉士 ² (東京大学 ¹ , 九州大学 ²)	10:15	12C-03 MEMS ミラーを用いた 1× 43 ポート波長選択スイッチ ○石井雄三, 葉玉恒一, 山口城治, 河尻祐子, 橋本 悦, 松浦 徹, 下 川房男, 佐藤康博 (日本電信電話株 式会社 NTT マイクロシステムイ ンテグレーション研究所)
10:30	12A-04 大型セラミック BGA パッ ケージの疲労寿命評価における効率 化 ○福園健治, 小出正輝, 渡邊真名武 (富士通アドバンステクノロジー株 式会社)	10:30	12B-04 高精度高真空接合装置の開発 須賀唯知 ¹ , 新谷啓行 ² , Matiar Howlader ³ , 澤田佳奈子 ⁴ , 重藤暁津 ⁵ , ○山内 朗 ⁶ (東京大学 ¹ , 同大学院 修士課程 ² , McMaster University ³ , (株)東芝 ⁴ , 物質材料研究機構 ⁵ , ボ ンドテック(株) ⁶)	10:30	12C-04 波長選択スイッチ (WSS) 用 MEMS ミラーアレイのモジュール 化技術 (2) ○確氷光男, 内山真吾, 橋本 悦, 葉玉恒一, 石井雄三, 松浦伸昭, 松 浦 徹, 阪田知巳, 下山展弘, 小館 淳一, 佐藤康博, 下川房男 (日本電 信電話株式会社 NTT マイクロシス テムインテグレーション研究所)
10:45	休憩	10:45	休憩	10:45	休憩
11:00	「信頼性解析技術」 座長：岡本健次(富士電機) 12A-05 依頼講演 SiC 素子に要求される実装技術 ○山口 浩 (産業技術総合研究所)	11:00	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：高木秀樹 (産業技術総合研究所) 12B-05 窒素雰囲気におけるシリコ ンウエハの低温接合 ○押川慧悟, 王 英輝, 須賀唯知 (東京大学)	11:00	「光回路実装技術」 座長：杉原興浩(東北大学) 12C-05 UV 硬化樹脂によるマイク ロホールアレイを用いた波長選択光イ ンターコネクション ○常盤諭生, 仲間健一, 三上 修 (東 海大学)
		11:15	12B-06 ギ酸ガスを用いた表面活性化 接合装置の試作について ○新谷啓行 ¹ , 赤池洋剛 ² , 須賀唯知 ² (東京大学大学院 ¹ , 東京大学 ²)	11:15	12C-06 自己形成光導波路の形状制御 と光インターコネクションへの応用 ○郭 命俊 ¹ , 神田昌宏 ¹ , 三上 修 ¹ , 米村正寿 ² , 河崎朱里 ² , 各務 学 ² (東 海大学大学院 ¹ , 豊田中央研究所 ²)
11:30	12A-06 Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだのク リープ疲労寿命評価 ○張 聖徳 ¹ , 小川真祐 ² , 坂根政男 ¹ , 小林 馨 ³ , 寺田健司 ³ (立命館大学 ¹ , 立命館大学大学院 ² , 京セラ SLC テ クノロジー株式会社 ³)	11:30	12B-07 ナノトランスファー法を用い た強誘電体膜の剥離特性 ○飯村慶太 ¹ , 細野智史 ¹ , 一木正 聡 ^{1,2} , 伊藤寿浩 ^{3,4} , 須賀唯知 ^{1,4} (東 京大学 ¹ , JST-PRESTO ² , 産業技術 総合研究所 ³ , JST-CREST ⁴)	11:30	12C-07 厚み方向テーパ構造ポリマー 光導波路の光結合特性 ○石澤信彦 ¹ , 神田昌宏 ¹ , 三上 修 ¹ , 塩田剛史 ² (東海大学 ¹ , 三井化学株 式会社 ²)
11:45	12A-07 累積損傷モデルによるはんだ 接合部の断線寿命予測 ○寺崎 健 ¹ , 谷江尚史 ¹ , 千綿伸彦 ² , 若野基樹 ³ , 藤吉 優 ² (株式会社日立 製作所機械研究所 ¹ , 日立金属冶金 研 ² , 日立金属安来工場 ³)	11:45	12B-08 強誘電体薄膜の電極構造とナ ノトランスファー法への応用 ○細野智史 ¹ , 飯村慶太 ¹ , 一木正 聡 ^{1,2,4} , 伊藤寿浩 ^{3,4} , 須賀唯知 ^{1,4} (東京大学工学部 ¹ , JST-PRESTO ² , 産 業 技 術 総 合 研 究 所 ³ , JST- CREST ⁴)	11:45	12C-08 屈折率分布型コアポリマー光 導波路の高密度配線とクロストーク 特性 ○石博崇明, 小杉友哉, 石黒亮太, 新 田陽介 (慶應義塾大学)

講演セッション 第3日目 (3月12日) (2/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	12C-09 共振器集積グレーティングカップラを用いた空間光導波光アドロップ素子 ○清水克也 ¹ , 金高健二 ² , 喜多由起 ¹ , 河波 慧 ¹ , 井上純一 ¹ , 西尾謙三 ¹ , 栗辻安浩 ¹ , 裏 升吾 ¹ (京都工芸繊維大学大学院 ¹ , 産業技術総合研究所 ²)
				12:15	12C-10 Si プラットフォーム上にハイブリッド集積した LiNbO ₃ 光変調器のカップリング効率と変調特性 ○多喜川 良 ¹ , 日暮栄治 ² , 須賀唯知 ¹ , 川西哲也 ³ (東京大学大学院 ¹ , 東京大学先端科学技術研究センター ² , 情報通信研究機構 ³)
				12:30	12C-11 ダイシングを用いた積層多チャンネルポリマー光導波路フィルムの作成 ○木下智嗣, 石田宏司 (千歳科学技術大学)
				12:45	休憩
13:00	ポスタワード 表彰式				
13:30	「環境調和型実装技術」 座長: 石井利明(日立製作所) 12A-08 依頼講演 電気自動車技術の現状と将来 ○田中謙司 (東京大学大学院)	13:30	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長: 伊藤寿浩 (産業技術総合研究所) 12B-09 依頼講演 ウェアブルシステムによる人間状態計測技術 一木正聡 ^{1, 5, 6} , ○才脇直樹 ² , 原 史朗 ³ , 鈴木章夫 ³ , 伊藤寿浩 ^{3, 5} , 薩本弥生 ⁴ (東京大学大学院 ¹ , 奈良女子大学 ² , 産業技術総合研究所 ³ , 横浜国立大学 ⁴ , JST-CREST ⁵ , JST-PRESTO ⁶)	13:30	「システムインテグレーション実装技術」 座長: 高野 希(日立化成工業) 12C-12 依頼講演 システムの性能向上に向けた SiP 実装技術の課題について ○今村和之 ¹ , 小出正輝 ² , 水越正孝 ³ , 石塚 剛 ¹ , 今泉延弘 ³ (富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 ¹ , 富士通アドバンストテクノロジー株式会社 ² , 株式会社富士通研究所 ³)
14:00	12A-09 自己組織化ハニカムマスクを用いたバイオミメティック表面を有するシリコン基板の作製 平井悠司 ¹ , 仲道裕貴 ¹ , 藪 浩 ¹ , 松尾保孝 ^{2, 3} , 居城邦治 ^{2, 3} , ○下村政嗣 ^{1, 3} (東北大学 ¹ , 北海道大学 ² , JST-CREST ³)	14:00	12B-10 陽極接合可能な LTCC の接合性能評価 ○岡田厚志 ¹ , 毛利 護 ¹ , 福士秀幸 ² , 松崎 栄 ² , 田中秀治 ² , 江刺正喜 ³ (ニッコー株式会社 ¹ , 東北大学大学院 ² , 東北大学 ³)	14:00	12C-13 電磁波遮蔽用の通気性 Cu/Ni めっきシールド技術の開発 ○依田智子 ¹ , 原 敦 ¹ , 白井優之 ² (日立製作所 生産技術研究所 ¹ , ルネサステクノロジ ²)
14:15	12A-10 Cu ナノ粒子ペーストの接合性に及ぼすプロセス条件の影響 ○平野智章 ¹ , 西川 宏 ² , 竹本 正 ² , 寺田信人 ³ (大阪大学大学院 ¹ , 大阪大学接合科学研究所 ² , ハリマ化成株式会社 ³)	14:15	12B-11 レーザ分光多点照射による MEMS ウェハ振動解析 ○吉田圭佑 ¹ , 末吉晴樹 ² , 今井一宏 ⁴ , 安河内裕司 ³ , 崔 雲 ¹ , 友景 肇 ¹ (福岡大学大学院 ¹ , 福岡県産業・科学技術振興財団 ² , 有限会社ユージ企画 ³ , 株式会社光コム ⁴)	14:15	12C-14 SiP と光 MEMS の融合による血流量センサの小型化 ○岩崎 渉 ¹ , 野上大史 ¹ , 伊藤宏記 ² , 日暮栄治 ³ , 澤田廉士 ^{1, 4} (九州大学大学院 ¹ , 九州大学 ² , 東京大学先端科学技術センター ³ , 九州大学工学部 ⁴)
14:30	12A-11 酸化銀マイクロ粒子を用いた <i>In-situ</i> 銀銅合金化接合技術 ○井出英一 ¹ , 守田俊章 ¹ , 川内祐治 ² (日立製作所材料研究所 ¹ , 日立金属株式会社 ²)	14:30	12B-12 表面弾性波による連続流体駆動と高効率攪拌を同時実現したマイクロ化学リアクターの提案 ○甲本武士 ¹ , 才木常正 ² , 岡田勝英 ¹ , 内海裕一 ¹ (兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 ¹ , 兵庫県立工業技術センター ²)	14:30	12C-15 無電解めっき法により Cu 微細配線上へ作製したフリップチップ接続用微細 Au パンプの評価 ○野村建太郎 ^{1, 2} , 横島時彦 ² , 加藤史樹 ² , 山地泰弘 ³ , 根本俊介 ³ , 菊地克弥 ² , 仲川 博 ² , 越地耕二 ¹ , 青柳昌宏 ^{1, 2} , 岩井良太 ³ , 徳久智明 ³ , 加藤勝 ³ (東京理科大学大学院 ¹ , 産業技術総合研究所 ² , 関東化学株式会社 ³)
14:45	12A-12 プロトンビームによるプラスチックの直接加工 ○狩野拓也 ¹ , 金子智紀 ² , 西川宏之 ^{1, 3} , 林 秀臣 ³ (芝浦工業大学 ¹ , 芝浦工業大学大学院 ² , 芝浦工業大学先端工学研究機構 ³)	14:45	休憩	14:45	休憩

講演セッション 第3日目 (3月12日) (3/3)

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】
15:00	12A-13 フィンを有する面の平均蒸発熱伝達係数の実験整理式による予測手法の確立 ○稲葉賢一, 吉川 実, 北城 栄(日本電気株式会社)	15:00	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長: 日暮栄治(東京大学) 12B-13 ミストジェット技術を用いたSi 微粒子塗布 ○横山吉典 ¹ , 村上隆昭 ¹ , 吉田幸久 ¹ , 伊藤寿浩 ^{1,2} (BEANS プロジェクト Macro BEANS センター ¹ , 産業技術総合研究所 ²)		
		15:15	12B-14 インクジェットによる石英ファイバへの Ag 配線技術 ○三村秋男 ¹ , 柴山学久 ¹ , 武田宗久 ¹ , 伊藤寿浩 ^{1,2} (BEANS プロジェクト Macro BEANS センター ¹ , AIST 先進製造プロセス研究部門 ²)		
		15:30	12B-15 導電性高分子ダイコーティング法を用いた大面積タッチセンサの製作方法に関する研究 ○高松誠一 ¹ , 小林 健 ¹ , 柴山学久 ² , 三宅浩司 ¹ , 伊藤寿浩 ^{1,2} (産業技術総合研究所 ¹ , BEANS 研究所 ²)		
		15:45	12B-16 圧電加速度センサを用いた超低消費電力イベント・ドリブン型無線センサ端末の開発 ○岡田浩尚 ¹ , 小林 健 ¹ , 増田 誉 ² , 伊藤寿浩 ¹ (産業技術総合研究所, CREST ¹ , 東京大学大学院, CREST ²)		
		16:00			

第3日目【3月12日】

ものづくりセッション

場所：D会場

		座長：本多 進（NPO サーキットネットワーク）
9:45	12D-01	低温焼結可能な銅超微粒子の合成と導電性材料への応用 ○井田清信，友成雅則（石原産業株式会社）
10:05	12D-02	鉛フリー化による実装上の課題 ○山美庸一（松尾ハンダ株式会社）
10:25	12D-03	高温観察装置〈SMT Scope〉の特長 平本 清，○鈴木孝啓（山陽精工株式会社）
10:45		休憩
		座長：和嶋元世（荏原ユーザライト）
11:00	12D-04	卓上型両面フライングプローバー『MF-C254』 ○土田憲吾（ヤマハファインテック株式会社）
11:20	12D-05	85℃ 85％ 環境下での絶縁体内部電荷分布経時変化の測定技術 ○河野唯通（ファイブラボ株式会社）
11:40	12D-06	次世代パッケージ基板用ダイレクトイメージング技術 ○小黑 健（日立ビアメカニクス株式会社）
12:00		休憩
		座長：星 幸紀（大昌電子）
13:20	12D-07	DCAM『START』の3次元実装技術紹介 ○斉藤和之（株式会社ファースト）
13:40	12D-08	非接触 JET ディスペンサー等による最新の液体精密制御技術 ○富山和照（武蔵エンジニアリング株式会社）
14:00	12D-09	次世代基板に向けたレーザ穴加工技術 ○久世 修，道上典男（日立ビアメカニクス株式会社）
14:20		休憩
		座長：高木 清 (YJC)
14:30	12D-10	高温度設定 (350℃)，低酸素濃度 (100 ppm) 対応リフロー装置 ○廣瀬 稔（日本アントム株式会社）
14:50	12D-11	実装用搬送治具の洗浄を溶剤不要にし秒速で洗浄且つ低コストを実現した次世代搬送治具洗浄装置 ○新井 功（シイエムケイメカニクス株式会社）
15:10	12D-12	電子回路，部品の振動試験の課題 ○小林敏之，井上良隆（IMV 株式会社）